

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0981)

中芯截至二零零八年九月三十日止三個月業績公佈

- 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（[中芯]或[本公司]）於今日公佈截至二零零八年九月三十日止三個月的綜合經營業績。
- 二零零八年第三季的總銷售額與二零零八年第二季相比上升 9.6%，增加至 375,900,000 元。特別是二零零八年第三季 0.13 微米及 90 納米邏輯產品銷售與第二季度比較增加了 23.3%。簡化平均售價由二零零八年第二季的 853 元增加至二零零八年第三季的 871 元，上升 2.1%。二零零八年第三季的毛利率與二零零八年第二季的 6.1%比較上升至 7.2%。二零零八年第三季淨虧損由二零零八年第二季的 45,600,000 元減少至 30,300,000 元。
- 以下為本公司於二零零八年十月二十九日就截至二零零八年九月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1)條規定的披露責任於二零零八年十月二十九日作出本公佈。

以下為本公司於二零零八年十月二十九日就截至二零零八年九月三十日止三個月的未經審核業績在報章所作的公佈全文。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海—二零零八年十月二十九日—國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零八年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零零八年第三季概要

- 二零零八年第三季的總銷售額與二零零八年第二季相比上升 9.6% 至 375,900,000 元，特別由於是二零零八年第三季 0.13 微米及 90 納米先進邏輯產品銷售與第二季度比較增加了 23.3%。
- 簡化平均售價（“平均售價”）由二零零八年第三季與二零零八年第二季的 853 元相比，上升 2.1% 至 871 元。
- 二零零八年第三季的毛利率與二零零八年第二季的 6.1% 相比，上升至 7.2%。
- 二零零八年第三季淨虧損與二零零八年第二季的 45,600,000 元相比，減少至 30,300,000 元。

中芯國際首席執行官張汝京博士就本季度的運營成果發表評論：「以第三季度的表現來說，我很高興地看到季度總收入增加了 9.6 %，增加的原因主要是由於今年第三季度邏輯需求量增加以及產能轉化後使得平均售價增加。邏輯晶片在第三季度的總出貨量相對第二季度增加了 9.9 %，佔總收入的 87.4 %。從客戶分類計算，無晶圓廠集成電路設計公司對總收入的貢獻比上季增加了 10.5 %，比去年同期增加 16.2 %。以產品分類計算，通訊類產品錄得了強勁銷售，第三季度的銷售比上季增加了 13.9 %。此外，應用消費類的銷售也在第三季度增加了 10.9 %。而第三季度的 DRAM 內存芯片收入則繼續縮減至僅佔總收入的 2.4 %。在 1.98 億美元的折舊和分期償還費用的結果下，我們錄得淨虧損三千零三十萬美元。從收入比例計算，折舊費用比例已比上一季度下降了 5 %。此外，從 2009 年起，上海 200mm 晶圓廠房的折舊費用將在其後兩年內下降近一半，這將進一步改善我們的利潤。至於利息，稅項，折舊及攤銷前的收入利潤（EBITDA）方面，則從第二季度的 42.5 % 上升至第三季度的 45.5 %。

在 2008 年第三季度，我們繼續在主要的戰略舉措取得進展。第一，DRAM 的產能轉換到邏輯如期進行中，估計於今年年底完成。完成後，我們預計北京 300mm 晶圓廠房於 2008 年年底的邏輯產量將相對年初增加超過 50 %。

對於先進技術的發展，我很高興地宣布，中芯國際已取得進入 32 納米技術紀元全部所須的出口許可證，包括邏輯及閃存記憶體的研究和開發，而有關許可將在 2009 年 1 月 1 日生效。在 65 納米技術發展上，我們已得到 20 多個產品投片，並分別處於不同的階段的認證中。而我們與 IBM 公司在 45 納米的合作上，進度也按照計劃進行中，我們希望在 2009 年下半年進行技術認證及試產。

我們很高興看到我們的中國客戶的進展及正提升他們的技術。在第三季度，我們對中國客戶的出貨量增長了 28 %，而來自大中華地區的銷售額約佔第三季度總收入的 31 %。正如我們先前宣布，由於合作過程順利，我們其中一個中國客戶已成功地開發了能被中國高清電視機採用的解調器芯片，成為中國數碼電視市場有史以來最全面的芯片解決方案。此外，另一

個中國客戶開發了‘中國·移動多媒體廣播’（CMMB）標準的移動電視解決方案。由中國政府提倡的CMMB目前覆蓋全國37個城市。另外，中國政府最近也開始為TD-SCDMA標準網絡的全面商業化使用進行基礎設施建設。而中國客戶也正與中芯國際共同生產有關芯片。TD-SCDMA技術標準目前已在進行試驗並已覆蓋了中國10個城市，在不久的將來更會擴大到國內其他28個城市。未來，我們計劃繼續與本土的無晶圓廠集成電路設計公司緊密合作，以持續加強重點於中國本土市場。

在目前的營商環境下，我們正在努力嚴格控制成本，並將暫停所有產能擴充直至我們能清晰掌握終端客戶的需求。

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零零八年十月三十日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-617-597-5342（密碼：SMIC）或香港 852-3002-1672（密碼：SMIC）。

二零零八年第三季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

關於中芯

中芯國際（“SMIC”，紐約證交所股票代碼:SMI，香港恒生股票代碼: 0981.HK）總部位於中國上海，是世界領先的集成電路晶片代工公司之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 65 納米及更先進的晶片製造服務。公司在上海的旗艦廠擁有一座 12 吋晶片廠及三座 8 吋晶片廠。北京旗艦廠建有兩座 12 吋晶片廠，在天津建有一座 8 吋晶片廠，在深圳的一座 8 吋晶片廠和一座 12 吋晶片廠正在建造中，在成都還建有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立銷售辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際受委託經營管理成都成芯半導體製造有限公司的一座 8 吋晶片廠，以及武漢新芯集成電路製造有限公司的一座 12 吋晶片廠。

詳細資訊請參考中芯國際網站<http://www.smics.com>

安全港聲明

（根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案）

本次新聞發佈可能載有（除歷史資料外）依據 1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，預期於年底前完成 DRAM 產能轉換到邏輯，北京 300mm 晶圓廠房於 2008 年年底的邏輯產量將相對年初增加，預期與 IBM 合作的 45 納米技術的認證及試產時間，預期 TD-SCDMA 技術標準在不久的將來擴大到國內其他 28 個城市，未來與無晶圓廠集成電路設計公司合作，暫停所有產能擴充的計劃，我們對二零零八年第四季銷售額的預期，中芯於二零零八年加強和改善盈利能力的預期，以及在隨後“資本概要”和“二零零八年第四季”指引等陳述乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，儘管並非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、現時環球金融危機、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會（「證交會」）的文件資料，包括其於二零零八年六月二十七日以 20-F 表格形式呈交予證交會的年度報告，特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份，以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所呈交的該等其他文件，包括 6-K 表格。其他未知或不可預知的因素亦可能會對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期（或如無有關日期，則為本新聞發佈日期）的情況而表述。除法律有所規定以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

重大訴訟

台積電法律訴訟之近期發展

於二零零六年八月二十五日，台積電入稟加州阿拉米達郡最高法院，就指稱本公司違反和解協議、違反承兌票據及不當使用商業機密而對本公司及若干附屬公司（中芯上海、中芯北京及中芯美國）提出訴訟。台積電訴求（其中包括）損害賠償、禁制令、律師費及提早支付和解協議項下尚未支付之金額。

在當前之訴訟中，台積電指稱本公司將台積電之商業機密運用於製造本公司 0.13 微米或更小之工藝產品。台積電進一步稱，由於本公司違約，有關台積電的專利授權已予終止，有關本公司較大工藝產品之不起訴承諾亦已失效。

本公司強烈否認所有不當使用之指控。截至目前為止，法院並未認定台積電的指控確屬有效，亦未設定審判日期。

本公司於二零零六年九月十三日公佈，除提出強烈否認台積電在美國訴訟提出的指控外，並已於二零零六年九月十二日反訴台積電，就（其中包括）台積電違反合約及違反默示的善意公平交易的契約，要求台積電作出損害賠償。

中華人民共和國北京市高級人民法院於二零零六年十一月十六日受理本公司及本公司的全資屬子公司中芯上海及中芯北京共同提起的針對台積電違反誠實信用原則、商業詆毀的不公平競爭行為的指控（「中國訴訟」）。在中國訴訟中，本公司尋求（其中包括）判令台積電停止侵權行為、公開向本公司道歉和賠償損失（包括台積電因其侵權行為所獲得的利潤）。

台積電於二零零七年一月向美國加州法院動議尋求禁制中國訴訟。於二零零七年二月，台積電向北京市高級人民法院提出司法管轄權的異議，質疑北京市高級人民法院對中國訴訟的司法管轄權。

二零零七年三月，加州法院駁回台積電有關禁制中國訴訟的聲請。台積電就該決定向加州上訴法院提出上訴。二零零八年三月二十六日，加州上訴法院以書面形式駁回台積電的上訴。

二零零七年七月，北京市高級人民法院駁回台積電對中國訴訟的司法管轄權的異議，並認為北京市高級人民法院對該訴訟擁有適當的司法管轄權。台積電就北京市高級人民法院的裁定，向中華人民共和國最高人民法院提出上訴。二零零八年一月七日，最高人民法院就台積電的上訴召開庭審。二零零八年六月十三日，最高人民法院駁回台積電的上訴，並確認了北京市高級人民法院的司法管轄權。

二零零七年八月十四日，本公司修訂對台積電提出的反訴，尋求（其中包括）台積電違約及違反專利授權協議的賠償。台積電隨後否認本公司關於修正反訴的指稱，並追加指稱本公司於北京市高級人民法院起訴台積電乃違反和解協議。本公司已否認台積電的該該追加指稱，並後續修訂對台積電提出的反訴，控告台積電不當使用本公司的商業機密。

二零零七年八月十五日至十七日，美國加州法院就台積電申請臨時禁制令尋求禁止本公司製造或銷售特定的 0.13 微米或以下的邏輯技術產品進行庭審。並於二零零七年九月七日作出裁定。該裁定拒絕台積電提出的臨時禁制令申請，本公司的業務發展和銷售因而得以不受影響。但該裁定要求本公司若計劃在某些情況下披露其邏輯技術予非中芯國際的機構時，必須給予台積電十天的通知以讓台積電可就該披露提出異議。

於二零零八年三月十一日，台積電在加州法院提出扣押命令的申請。依該申請，台積電尋求確保獲取本公司依和解協議及承兌票據尚未支付的餘額。本公司反對該項申請。庭審已於二零零八年四月三日召開。二零零八年六月二十四日，法院駁回了台積電的該項申請。

於二零零八年五月，台積電就本公司的多項反訴向加州法院提交請求簡易判決的聲請。本公司反對該聲請，二零零八年七月二十五日，法院決定部分批准並部分駁回台積電聲請。

二零零八年六月二十三日，本公司向加州法院對台積電提出反訴，就（其中包括）台積電非法不當使用本公司的商業機密以提升其對本公司的競爭地位尋求賠償。

二零零八年七月十日，加州法院就台積電申請臨時禁制令欲禁止本公司向第三方披露有關 0.30 微米邏輯技術產品的若干制程配方的資料作出庭審，並決定批准部分該禁制聲請。

根據美國財務會計準則第 144 號，本公司須決定該未決訴訟是否構成需要進一步分析專利許可組合是否已受損害之事件。我們相信，該法律訴訟現處於早期階段，我們仍在評估訴訟是否屬於該類事件。本公司預期將獲得進一步資料以協助我們作出決定。根據美國財務會計準則第 144 號進行之任何損害分析結果可能對本公司財政狀況及經營業績產生重大影響。由於訴訟仍處於早期階段，本公司未能評估頒佈不利判決的可能性或估計潛在虧損的金額或範圍。

投資者聯絡資料：

En-Ling Feng

电话：+86-21-5080-2000，内线： 16275

Enling_Feng@smics.com

Anne Wong Chen

电话：+86-21-5080-2000，内线： 12804

Anne_CAYW@smics.com

二零零八年第三季經營業績概要：

以千美元為單位（每股盈利和百分比除外）

	二零零八年第 三季度	二零零八年第 二季度	季度比較	二零零七年第 三季度	年度比較
銷售收入	375,945	342,919	9.6%	391,398	-3.9%
銷售成本	348,721	322,077	8.3%	349,148	-0.1%
毛利	27,224	20,842	30.6%	42,250	-35.6%
經營開支	40,451	60,750	-33.4%	62,435	-35.2%
經營虧損	(13,227)	(39,908)	-66.9%	(20,185)	-34.5%
其他收入支出，淨額	(15,631)	(5,193)	201.0%	(4,342)	260.0%
所得稅支出	(4,499)	(2,046)	119.9%	(966)	365.7%
稅後淨虧損	(33,357)	(47,147)	-29.2%	(25,493)	30.8%
少數股權	3,094	1,603	93.0%	859	260.2%
應占聯營公司虧損	(26)	(85)	-69.4%	(919)	-97.2%
普通股持有人應占虧損	(30,289)	(45,629)	-33.6%	(25,553)	18.5%
毛利率	7.2%	6.1%		10.8%	
經營利潤率	-3.5%	-11.6%		-5.2%	
每股普通股股份淨虧損—基本(1)	(0.0016)	(0.0025)		(0.0014)	
每股美國預托股股份淨虧損—基本	(0.0814)	(0.1227)		(0.0690)	
每股普通股股份淨虧損—攤薄(1)	(0.0016)	(0.0025)		(0.0014)	
每股美國預托股股份淨虧損—攤薄	(0.0814)	(0.1227)		(0.0690)	
付運晶圓（8吋等值）(2)	431,660	402,114	7.3%	458,466	-5.8%
產能使用率	90.5%	92.2%		94.1%	

附注：

(1) 基於二零零八年第三季加權平均普通股 18,612,000,000 股（基本）及 18,612,000,000 股（攤薄），二零零八年第二季 18,589,000,000 股（基本）及 18,589,000,000 股（攤薄），二零零七年第三季 18,523,000,000 股（基本）及 18,523,000,000 股（攤薄）

(2) 包括銅接連件

- 二零零八年第三季總銷售額與二零零八年第二季的 342,900,000 元相比，上升 9.6% 至 375,900,000 元是由於 0.13 微米或以下技術產品的銷售增加，與二零零七年第三季度的 391,400,000 元相比，下降 3.9%。
- 二零零八年第三季的簡化平均售價與二零零八年第二季 853 元相比，上升 2.1% 至 871 元。
- 二零零八年第三季的銷售成本與二零零八年第二季的 322,100,000 元相比，上升 8.3% 至 348,700,000 元，主要是由於晶元付運數量增加。
- 二零零八年第三季的毛利與二零零八年第二季的 20,800,000 元相比，上升 30.6% 至 27,200,000 元，與二零零七年第三季的 42,300,000 元相比，下降 35.6%。
- 二零零八年第三季的毛利率由二零零八年第二季 6.1% 上升至 7.2%。
- 二零零八年第三季的總經營開支與二零零八年第二季的 60,800,000 元相比，錄得季度下降 33.4% 至 40,500,000 元，主要由於研發費用和一般行政費用支出的減少。
- 二零零八年第三季的研發費用與二零零八年第二季的相比，從 37,700,000 元下降 52.7% 至 17,800,000 元，主要由於二零零八年第三季政府補助金的增加。
- 二零零八年第三季的一般行政費與二零零八年第二季的 13,300,000 元相比，下降至 10,800,000 元，主要由於法律費用減少。
- 二零零八年第三季的銷售費用由二零零八年第二季的 4,400,000 元相比，錄得季度升幅 28.1% 至 5,600,000 元，主要是發生了與銷售行為相關的稅費所致。

收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零零八年第三季	二零零八年第二季	二零零七年第三季
電腦	5.4%	7.9%	22.7%
通訊	53.0%	51.1%	50.0%
消費	32.8%	32.4%	18.3%
其他	8.8%	8.6%	9.0%
以服務分類	二零零八年第三季	二零零八年第二季	二零零七年第三季
邏輯 (3)	87.4%	85.7%	66.8%
記憶	2.3%	3.6%	23.6%
管理服務	2.4%	2.6%	3.1%
光罩製造，探測及其它	7.9%	8.1%	6.5%
以客戶類別分類	二零零八年第三季	二零零八年第二季	二零零七年第三季
非廠房半導體公司	55.1%	54.6%	45.5%

集成裝置製造商	26.1%	25.7%	40.0%
系統公司及其它	18.8%	19.7%	14.5%
以地區分類	二零零八年第 三季度	二零零八年第 二季度	二零零七年第 三季度
北美洲	58.6%	55.1%	44.7%
亞太區（不包括日本）	34.6%	34.7%	26.4%
日本	2.1%	3.6%	10.1%
歐洲	4.7%	6.6%	18.8%
晶圓收入分析			
各技術占晶圓銷售額的百分比（僅包括邏輯、 記憶及銅接連件）	二零零八年第 三季度	二零零八年第 二季度	二零零七年第 三季度
0.09 微米	19.4%	18.4%	26.7%
0.13 微米	25.1%	22.9%	28.6%
0.15 微米	2.0%	2.1%	2.0%
0.18 微米	33.9%	37.7%	28.8%
0.25 微米	0.5%	0.6%	1.0%
0.35 微米	19.1%	18.3%	12.9%
各邏輯技術占邏輯晶圓銷售額百分比(1)	二零零八年第 三季度	二零零八年第 二季度	二零零七年第 三季度
0.09 微米	19.4%	16.4%	13.7%
0.13 微米（2）	23.2%	21.8%	22.7%
0.15 微米	2.0%	2.2%	2.7%
0.18 微米	35.0%	39.6%	41.0%
0.25 微米	0.5%	0.6%	1.4%
0.35 微米	19.9%	19.4%	18.5%

附注：

- (1) 不包括 0.13 微米銅接連件
- (2) 代表来自于全流程製造晶圓的銷售收入
- (3) 包括 0.13 微米銅接連件

產能：

廠／（晶圓尺寸）	二零零八年第 三季度*	二零零八年第 二季度*
上海廠（8 吋）	88,000	86,000
北京廠（12 吋）	36,000	40,500
天津廠（8 吋）	30,000	28,000
每月晶圓裝配總產能	154,000	154,500

附注：

*期終每月晶圓計 8 吋等值

付運及使用率：

8 吋等值晶圓	二零零八年第 三季度	二零零八年第 二季度	二零零七年第 三季度
付運晶圓（包括銅接連件）	431,660	402,114	458,466
使用率(1)	90.5%	92.2%	94.1%

附注：

(1) 產能使用率按輸出品圓總額除以估計產能計算

- 二零零八年第三季晶圓付運數量較二零零八年第二季的 402,114 片 8 吋等值晶圓增加 7.3%至 431,660 片 8 吋等值晶圓，較二零零七年第三季度的 458,466 片 8 吋等值晶圓錄得年度降幅 -5.8%。
- 二零零八年第三季邏輯產品的出貨量增加至 396,169 片 8 吋等值晶圓，較二零零八年第二季與二零零七年第三季度，分別錄得季度升幅 9.9%及年度升幅 32.1%。

2. 詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零零八年第 三季度	二零零八年第 二季度	季度比較	二零零七年 第三季度	年度比較
銷售成本	348,721	322,077	8.3%	349,148	-0.1%
折舊	165,641	153,783	7.7%	151,720	9.2%
其他製造成本	176,329	160,938	9.6%	189,069	-6.7%
遞延成本攤銷	5,886	5,886		5,886	
股權報酬	865	1,470	-41.2%	2,473	-65.0%
毛利	27,224	20,842	30.6%	42,250	-35.6%
毛利率	7.2%	6.1%		10.8%	

- 二零零八年第三季的銷售成本與二零零八年第二季的 322,100,000 元相比，錄得季度升幅 8.3%至 348,700,000 元。
- 二零零八年第三季的毛利與二零零八年第二季的 20,800,000 元相比，錄得季度升幅 30.6%至 27,200,000 元，與二零零七年第三季的毛利 42,300,000 元相比下，則錄得年度下降 35.6%。
- 二零零八年第三季的毛利率由二零零八年第二季的 6.1%增加至 7.2%。

經營開支分析

以千美元計	二零零八年第 三季度	二零零八年第 二季度	季度比較	二零零七年 第三季度	年度比較
總經營開支	40,451	60,750	-33.4%	62,435	-35.2%
研究及開發	17,838	37,684	-52.7%	25,906	-31.1%
一般及行政	10,761	13,328	-19.3%	23,836	-54.9%
銷售及市場推廣	5,578	4,356	28.1%	4,901	13.8%
無形資產攤銷	6,906	6,899	0.1%	7,751	-10.9%
資產處置(收入)虧損	(632)	(1,517)	-	41	-

- 二零零八年第三季的總經營開支與二零零八年第二季的 60,800,000 元相比，錄得季度下降 33.4%至 40,500,000 元，主要由於研發費用和一般行政費用支出的減少。
- 二零零八年第三季的研發費用與二零零八年第二季的相比，從 37,700,000 元下降 52.7%至 17,800,000 元，主要由於二零零八年第三季政府補助金的增加。
- 二零零八年第三季的一般行政費與二零零八年第二季的 13,300,000 元相比，下降至 10,800,000 元，主要由於法律費用減少。
- 二零零八年第三季的銷售費用由二零零八年第二季的 4,400,000 元相比，錄得季度升幅 28.1%至 5,600,000 元，主要是發生了與銷售行為相關的稅費所致。

其他收入(支出)

以千美元計	二零零八年第 三季度	二零零八年第 二季度	季度比較	二零零七年 第三季度	年度比較
其他支出	(15,631)	(5,193)	201.0%	(4,342)	260.0%
利息收入	2,542	4,059	-37.4%	2,819	-9.8%
利息支出	(11,088)	(15,279)	-27.4%	(14,791)	-25.0%
其他，淨額	(7,085)	6,027	-	7,629	-

- 二零零八年第三季的利息費用相對於二零零八年第二季度的減少，主要是由於二零零八年第三季平均貸款餘額減少及資本化利息費用增加所致。
- 其他、淨額的增加，主要是由於二零零八年第三季非經營性活動 7,000,000 元匯兌損失與二零零八年第二季獲得的匯兌收益 2,500,000 元。綜合經營性活動的匯兌收益，二零零八年第三季的總匯兌損失為 4,600,000 元與二零零八年第二季的總匯兌收益為 7,800,000 元。

流動資金

以千美元計	二零零八年第 三季度	二零零八年第 二季度
現金及現金等價物	392,881	480,265
限制性現金	3,000	91,130

短期投資	50,646	32,326
應收賬款	285,874	262,418
存貨	233,022	252,394
其它	72,272	64,767
流動資產總計	1,037,695	1,183,300
應付賬款	301,712	345,801
短期借款	212,600	242,908
長期借款的即期部份	340,355	341,630
其它	177,736	159,958
流動負債總計	1,032,403	1,090,297
現金比率	0.3x	0.5x
速動比率	0.7x	0.8x
流動比率	1.0x	1.1x

資本結構

以千美元計	二零零八年第 三季度	二零零八年第 二季度
現金及現金等價物	392,881	480,265
限制性現金	3,000	91,130
短期投資	50,646	32,326
長期票據即期部分	29,493	29,242
長期票據	37,762	37,441
短期借款	212,600	242,908
長期借款的即期部份	340,355	341,630
長期借款	692,131	695,292
總借款	1,245,086	1,279,830
股東權益	2,721,561	2,749,470
總借款對權益比率	45.7%	46.5%

現金流量概要

以千美元計	二零零八年第 三季度	二零零八年第 二季度
來自于經營活動的現金淨額	110,119	147,211
來自于投資活動的現金淨額	(162,773)	(320,120)
來自于融資活動的現金淨額	(34,668)	146,927
現金變動淨額	(87,384)	(26,055)

資本開支概要

- 二零零八年第三季資本開支為 242,000,000 元。
- 二零零八年預期的資本開支總額將約為 790,000,000 元。資本開支基本用作擴張 8 英寸晶圓廠，北京廠由記憶體產能轉換為邏輯產能以及研發活動。

二零零八年第四季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已于之前的安全港聲明中闡明。

- 銷售額預期由二零零八年第三季下降 25% 至 29%。
- 經營開支相對銷售的百分比預期為 15% 左右。
- 資本支出預期 介於 165,000,000 元到 195,000,000 元之間。

近期公佈

- 中芯國際重申第三季度營收指引不變（二零零八年九月二十八日）
- 中芯國際 S2/FAB 8 通過 ISO 27001 信息安全管理體系認證（二零零八年九月二十六日）
- 中芯國際 2008 年技術研討會在上海召開（二零零八年九月十九日）
- 截至二零零八年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈（二零零八年九月十九日）
- Spansion 與中芯國際的合作協議新添 43nm 制程 MirrorBit ORNAND2 技術（二零零八年九月二十二日）
- 張汝京榮任 2008 北京奧運會火炬手 傳遞北京經濟技術開發區最後一棒（二零零八年八月八日）
- Telepath (泰合志恒) 攜手英飛凌和中芯國際合作使得多種移動電視接收設備于奧運成功推出（二零零八年八月四日）
- 中芯截至二零零八年六月三十日止三個月業績公佈（二零零八年七月二十八日）

上述公佈詳情請參閱中芯網站。

http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/pressRelease.jsp

合并資產負債表
(美元)

截至以下日期止

	二零零八年 九月三十日 (未經審核)	二零零八年 六月三十日 (未經審核)
資產		
流動資產：		
現金及現金等價物	392,881,020	480,265,390
限定用途的現金	3,000,000	91,129,665
短期投資	50,645,536	32,325,653
應收賬款，已扣除撥備（二零零八年九月三十日為4,697,378元，二零零八年六月三十日為4,491,881元）	285,873,827	262,418,476
存貨	233,022,657	252,393,858
預付款項及其它流動資產	52,768,850	43,757,844
廠房、機台及其它固定資產銷售應收款	19,503,560	19,503,560
待售資產	-	1,505,287
流動資產合計	1,037,695,450	1,183,299,733
土地使用權，淨額	74,437,989	56,973,227
廠房及設備，淨額	3,106,399,766	3,073,939,856
購入無形資產，淨額	212,611,259	219,542,603
遞延成本	52,977,956	58,864,395
股權投資	11,444,506	9,570,309
其它長期預付款	2,379,500	2,431,307
遞延稅資產	43,971,049	44,482,712
資產合計	4,541,917,475	4,649,104,142
負債及股東權益		
流動負債：		
應付帳款	301,711,981	345,801,391
預提費用及其它流動負債	147,725,420	130,233,266
短期借款	212,600,414	242,907,613
長期票據的即期部份	29,492,873	29,242,001
長期借款的即期部份	340,355,129	341,630,053
應付所得稅	517,682	482,264
流動負債合計	1,032,403,499	1,090,296,588
長期負債：		
長期票據	37,762,091	37,440,879
長期借款	692,131,401	695,291,528

與特許權協議相關的長期應付款	28,037,163	43,488,864
遞延稅負債	621,029	621,029
長期負債合計	758,551,684	776,842,300
負債合計	1,790,955,183	1,867,138,888
少數股權	29,401,201	32,495,675
股東權益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，截止二零零八年九月三十日已發行股份為 18,619,884,481 股，截止二零零八年六月三十日已發行的股份為 18,592,920,335 股。	7,447,954	7,437,168
額外繳入股本	3,323,364,177	3,320,932,081
累計其它綜合虧損	(199,305)	(137,073)
累計虧絀	(609,051,735)	(578,762,598)
所有股東權益合計	2,721,561,091	2,749,469,578
總負債及股東權益合計	4,541,917,475	4,649,104,142

合并營運報表
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零八年 九月三十日 (未經審核)	二零零八年 六月三十日 (未經審核)
銷售額	375,944,833	342,919,148
銷售成本	348,720,498	322,076,702
毛利	27,224,335	20,842,446
經營費用：		
研究和開發	17,838,076	37,684,073
一般及行政	10,760,722	13,328,153
銷售和市場推廣	5,578,365	4,356,161
購入無形資產攤銷	6,906,344	6,898,279
來自廠房設備和其它固定資產的銷售損失(所得)	(632,029)	(1,516,754)
經營費用總額	40,451,478	60,749,912
經營虧損	(13,227,143)	(39,907,466)
其它收入(支出)：		
利息收入	2,541,743	4,058,901
利息支出	(11,087,893)	(15,279,685)
匯兌收益(虧損)	(7,022,913)	2,478,287
其它收入(支出)，淨額	(62,216)	3,549,159
其它收入(支出)，淨額	(15,631,279)	(5,193,338)
所得稅、少數股權及股權投資虧損前淨虧損	(28,858,422)	(45,100,804)
所得稅費用	(4,499,387)	(2,046,464)
少數股權	3,094,474	1,602,964
股權投資虧損	(25,803)	(85,122)
淨虧損	(30,289,138)	(45,629,426)
每股股份淨虧損，基本	(0.0016)	(0.0025)

每股美國預托股份淨虧損，基本	(0.0814)	(0.1227)
每股股份淨虧損，攤薄	(0.0016)	(0.0025)
每股美國預托股份淨虧損，攤薄	(0.0814)	(0.1227)
用作計算基本每股普通股 虧損額的股份	18,612,441,880	18,589,202,067
用作計算攤薄每股普通股 虧損額的股份	18,612,441,880	18,589,202,067

* 遞延股票報酬攤銷乃關於：

合并现金流量表
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零八年 九月三十日 (未經審核)	二零零八年 六月三十日 (未經審核)
經營活動：		
淨虧損	(30,289,138)	(45,629,426)
淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整：		
少數股權	(3,094,474)	(1,602,964)
遞延稅	511,663	(6,223,931)
處置廠房及設備收益	(632,029)	(1,516,754)
折舊及攤銷	188,387,781	187,912,371
購入無形資產攤銷	6,931,344	6,898,279
股權報酬	2,368,706	3,293,295
長期票據非現金利息費用	1,522,485	1,839,073
股權投資虧損	25,803	85,122
營運資產及負債的變動：		
應收賬款，淨額	(23,455,351)	21,513,042
存貨	19,371,201	(36,234,839)
預付款及其它流動資產	(9,608,778)	(6,011,332)
應付賬款	(57,377,721)	33,225,078
預提費用及其它流動負債	15,422,174	(10,301,330)
應付所得稅	35,418	(34,187)
經營活動所得現金淨額	110,119,084	147,211,497
投資活動：		
購入廠房及設備	(220,937,580)	(204,346,529)
處置廠房及設備所得款項	3,920,056	9,157
出售待售資產所得款項	1,004,594	642,452
購買所獲無形資產	(14,670,000)	(22,443,824)
購買短期投資	(154,185,792)	(94,846,471)
購買股權投資	(1,900,000)	
出售短期投資	135,865,909	91,994,718
轉換限定用途的現金	88,129,665	(91,129,665)
投資活動所耗現金淨額	(162,773,148)	(320,120,162)

融資活動：

短期借款所得款項	84,680,413	208,437,613
長期借款所得款項	–	227,024,023
償還長期票據支付的款項	–	(15,000,000)
償還長期借款支付的款項	(4,435,051)	(170,780,962)
償還短期借款支付的款項	(114,987,613)	(103,000,000)
行使雇員購股權所得款項	74,176	246,496
		–
		–
融資活動（所耗）所得現金淨額	(34,668,075)	146,927,170
匯率變動的影響	(62,231)	(73,428)
現金及現金等價物減少淨額	(87,384,370)	(26,054,923)
現金及現金等價物—期間開始	480,265,390	506,320,313
現金及現金等價物—期間結束	392,881,020	480,265,390

於本公佈刊發日期，本公司董事分別有董事會主席兼獨立非執行董事王陽元先生、本公司總裁、首席執行官兼執行董事張汝京先生、本公司非執行董事汪正綱先生、以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、蕭崇河先生、陳立武先生及江上舟先生。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
首席執行官
張汝京

中國上海，二零零八年十月二十九日
* 僅供識別